

要求特性・課題・トラブル対策までを習得するための

セミナーご案内 関連部署へご回覧願います

LIVE配信 アーカイブ配信	レジスト/EUVレジスト・微細加工用材料の基礎と具体的なトラブル対策
7日間何度でも視聴可能	

- ◆日時：2025年2月6日(木) 10:00~16:00 ◆受講料：(消費税等込) 1名:49,500円
同一セミナー 同一企業同時複数人数申込の場合 1名:44,000円
- ◆会場：WEB受講のみ (Zoomシステム) ◆受講資料：製本テキスト(受講料に含)
ライブ配信/アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可) ※別途テキストの送付先1件につき、配送料1,210円 (内税)
※当日の出席・欠席の有無は問いません

リソグラフィの基礎知識・最新技術、レジスト材料・微細加工用材料の基礎、 微細加工用材料の特性、レジスト材料・微細加工用材料の課題・対策、 レジスト材料の最新技術・ビジネス動向まで、 具体的に分かりやすく解説する特別セミナー !!

【講師の言葉】

本講演では、リソグラフィの基礎を解説した後、デバイスの微細化を支えるレジストの基礎をEUVレジスト（化学増幅型EUVレジスト、EUVネガレジストプロセス、EUVメタルレジスト、EUVメタルドライレジストプロセス）の詳細を含めて述べます。

レジスト・微細加工用材料のトラブル対策をその要求特性、課題をふまえて解説します。EUVレジストの課題と対策についても述べます。最後に最新のロードマップと先端デバイスの動向を解説し、今後のレジスト・微細加工用材料の技術展望、市場動向についてまとめます。

- 【受講形式】** WEB受講のみ ※本セミナーは、Zoomシステムを利用したオンライン配信となります。
- 【受講対象】** 本テーマに興味のある企業の研究者・技術者
製造販売担当
新規事業開発担当
企画担当
特許担当
市場アナリストの方
これらの職種を希望される学生の方 など
- 【予備知識】** 基本から解説しますので予備知識は不要です。
- 【習得知識】** 1) レジスト/EUVレジスト・微細加工用材料の基礎
2) リソグラフィの基礎
3) レジスト/EUVレジスト・微細加工用材料のトラブル対策
4) レジスト/EUVレジスト・微細加工用材料の最新技術・ビジネス動向 など

●申込書・2025年2月6日(木)「レジスト/EUVレジスト・微細加工用材料の基礎と具体的なトラブル対策」

会社名	〒	住所
TEL		FAX
正式所属		正式所属
受講者名		受講者名
E-mail		E-mail
振り込み 予定		通信欄


◆ プログラム ◆

【講師】 Eリソリサーチ 代表 遠藤 政孝 先生
工学博士
松下電器産業、大阪大学産業科学研究所を経て現在に至る

- 1. リソグラフィの基礎
 - 1.1 露光
 - 1.2 照明方法
 - 1.2.1 輪帯照明
 - 1.3 マスク
 - 1.3.1 位相シフトマスク
 - 1.3.2 光近接効果補正(OPC)
 - 1.3.3 マスクエラーファクター(MEF)
- 2. レジストの基礎
 - 2.1 溶解阻害型レジスト
 - 2.1.1 g線レジスト
 - 2.1.2 i線レジスト
 - 2.2 化学増幅型レジスト
 - 2.2.1 KrFレジスト
 - 2.2.2 ArFレジスト
 - 2.3 ArF液浸レジスト/トップコート
 - 2.4 EUVレジスト
 - 2.4.1 化学増幅型EUVレジスト
 - 2.4.2 EUVネガレジストプロセス
 - 2.4.3 EUVメタルレジスト
 - 2.4.4 EUVメタルドライレジストプロセス
- 3. レジスト・微細加工用材料のトラブル対策
 - 3.1 レジストパターン形成不良への対応
 - 3.1.1 パターン倒れ
 - 3.1.2 パターン密着性不良
 - 3.1.3 パターン形状不良
 - 3.1.4 チップ内のパターン均一性不良
 - 3.2 化学増幅型レジストのトラブル対策
 - 3.2.1 レジスト材料の安定性
 - 3.2.2 パターン形成時の基板からの影響
 - 3.2.3 パターン形成時の大気からの影響
 - 3.3 ArF液浸レジストのトラブル対策
 - 3.4 ダブルパターンニング、マルチパターンニングのトラブル対策
 - 3.4.1 リソエッチ(LE)プロセス用材料
 - 3.4.2 セルフアラインド(SA)プロセス用材料
 - 3.5 EUVレジストの課題と対策
 - 3.5.1 感度/解像度/ラフネスのトレードオフ
 - 3.5.2 ランダム欠陥(Stochastic Effects)
 - 3.6 自己組織化(DSA)リソグラフィのトラブル対策
 - 3.6.1 グラフォエピタキシー用材料
 - 3.6.2 ケミカルエピタキシー用材料
 - 3.7 ナノインプリントリソグラフィのトラブル対策
 - 3.7.1 加圧方式ナノインプリントリソグラフィ
 - 3.7.2 光硬化方式ナノインプリントリソグラフィ
- 4. 最新のロードマップと先端デバイスの動向
- 5. レジスト・微細加工用材料の技術展望、市場動向
質疑・応答

◆セミナーお申込要領

- 申し込み方法
・弊社ホームページの申込欄又は、FAXかE-mailにてお申し込みください。
・折り返し、受講票、請求書、会場案内図をお送り致します。
・開催日の8日前以内のキャンセルは、お受け致しかねますので、必要に応じ代理の方のご出席をお願いします。
・開催日の8日前以内のキャンセルの場合、受講料の全額を申し受けます。
- お支払い方法
受講料は原則として開催前日までにお支払い願います。経理上、受講料のお支払いがセミナー開催後になる場合は、お支払日をお知らせ願います。振り込み手数料は御社の御負担にてお願いします。

●申込先 

〒108-0014 東京都港区芝4-5-1 11-5F
TEL: 03-6435-1138
FAX: 03-6435-3685
E-mail: th@thplan.com

検索 TH企画 → サイト内検索 0206 (開催日)

詳細、その他のセミナーは、ホームページをご覧ください。
<https://www.thplan.com/>